

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

沪士电子股份有限公司 投资者活动记录表

编号：2025-0519-012

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称 及人员姓名	ARTISAN PARTNERS BLACKROCK 汇添富基金 易方达基金 FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH(FMR) FULLERTON FUND MANAGEMENT GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GIC PRIVATE LIMITED HEL VED CAPITAL MANAGEMENT LIMITED JENNISON ASSET MGT LAZARD ASSET MANAGEMENT PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED SANDS CAPITAL MANAGEMENT LLC UG INVESTMENT ADVISERS LTD J.P.MORGAN (参会者已签署书面调研承诺函，在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。下文会议纪要中的内容不代表公司对未来的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。)
时间	2025年5月19日 16:30-17:40
地点	会议室
公司接待 人员姓名	钱元君、王术梅

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、发展历程和经营策略</p> <p>简要介绍公司历史沿革、发展历程。公司 PCB 产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域。公司始终坚持实施差异化产品竞争战略依靠技术、管理和服务的比较竞争优势，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品。公司差异化经营，将技术能力、制程能力、产能结构动态适配市场中长期的需求结构，坚持面向整体市场的主要头部客户群体开展业务。我们定期报告中披露的前五大客户，在 2024 年收入同比实现不错成长的同时，公司还是努力保持行业头部客户的均衡，公司向来注重中长期的可持续利益，而非仅仅局限于眼前的短期利益。</p> <p>公司深知只有着眼长远，保持客户均衡，才能在不断变化的市场环境中稳健发展，实现可持续增长。公司需要准确把握未来的产品与技术方向，在超高密度集成、超高速信号传输等方面持续加大技术和创新方面的资源投入，通过技术创新、均衡的多元化客户结构、供应链韧性及区域布局，在复杂的市场环境中保持韧性和竞争优势，在不确定中锚定确定性。</p> <p>2、资本开支及市场需求</p> <p>AI 驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施需求增长以及新兴应用领域的拓展为行业带来发展机遇，市场上相关高阶产品的产能供应并不充裕，公司近两年已加大对关键制程和瓶颈制程的投资力度，预计 2025 年下半年产能将得到有效改善。公司近两年加快资本开支，现金流量也有相应的体现。2025 年第一季度财报现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约 6.58 亿。公司在 2024 年 Q4 规划新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目，生产高层高密度互连积层板，以满足高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求，项目将分两阶段实施，投资总额预计约为 43 亿元人民币，预期该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。</p> <p>从中长期看，人工智能和网络基础设施的发展需要更复杂、更高性能、更高层和高密度互连（HDI）的 PCB 产品，以支持其复杂的计算和数据处理需求，为 PCB 市场带来新的增长机遇，同时也对 PCB 企业的技术能力和创新能力提出了更高的挑战。更多的同行也纷纷将资源向该领域倾斜，试图进入该领域并取</p>
---------------------------	--

	<p>得一定的市场份额，未来的竞争势必会加剧。公司需要准确把握战略节奏，适度加快投资的步伐，通过深入分析市场趋势和自身发展需求，合理配置资源，将更多的资金投入到具有潜力和创新的领域，不断进行技术升级和创新，开发更高密度的互连技术、更高速的传输性能等，提高产品的竞争力，并快速响应市场需求，从而抢占市场先机，筑牢并拓展“根据地”业务，实现可持续发展。</p> <p style="text-align: center;">3、汽车板市场情况</p> <p>汽车 PCB 市场处在中低端供给过剩、价格竞争、原材料价格波动、技术研发压力等复杂的环境中，呈现出规模增长、竞争加剧、需求结构变化、技术创新加速等特征。智能化成为市场重要趋势，车企加快推动智能化迭代升级，L2 级辅助驾驶逐步普及，城市导航辅助驾驶落地加速，并将智驾下放到更低价位车型。技术创新将持续引领汽车 PCB 市场发展，需求结构也将不断变化，随着市场竞争的加剧，行业内中低端供给过剩的产能或将经历清理和优化调整。公司密切关注市场需求变化，依托深耕多年的通讯设备、汽车电子领域底层技术积累和创新能力以及在客户端长期累积的安全、稳定、可靠的产品质量信誉，与客户在新能源车三电系统，自动驾驶辅助，智能座舱，车联网等方面深度合作，加快新技术的研发投入，开展关键技术的研发，深度参与客户前期设计及验证，紧跟汽车行业的发展趋势，提升技术能力和适用性，增强与客户在技术上的准确支持以及在业务上的长期合作，逐步调整优化产品和产能结构，以应对市场挑战。此外公司通过和产业链合作伙伴的深度合作，持续推进应用于 800V 高压架构的产品技术优化和转移，推动采用 P2Pack 技术的产品在纯电动汽车驱动系统等方面的商业化应用。</p> <p style="text-align: center;">4、泰国工厂</p> <p>公司正在全员攻坚，推动沪士泰国生产基地从试生产到量产，并尽快达到预期的生产效率和产品质量，形成规模化量产能力，已全面加速开启客户认证与产品导入工作，逐步释放产能，并进一步验证中高端产品的生产能力，为逐步提高产品梯次打好基础，为未来的市场竞争做好准备。同时借助精细化成本管控手段，以有效控制初期成本；搭建全方位风险预警与应对机制以应对海外工厂建设运营风险，夯稳实现经营性盈利目标的桩基。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 19 日